**応募フォーム（Hi-EOP）**

別紙

提出日：　　　年　　月　　日

|  |  |
| --- | --- |
| 提案の名称(日本語) |  |
| 提案の名称(英語) |  |

**１．代表者情報**

|  |  |
| --- | --- |
| 代表者氏名(ふりがな) |   |
| 所属/職位 |   |
| プロジェクトでの役割 |   |
| 連絡先 | TEL： e-mail： |

**２．メンバー情報（適宜追加してください）**

|  |  |
| --- | --- |
|  氏名(ふりがな) |  |
| 所属/職位または学年 |  |
| プロジェクトでの役割 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 氏名(ふりがな) |   |
| 所属/職位または学年 |  |
| プロジェクトでの役割 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 氏名(ふりがな) |   |
| 所属/職位または学年 |  |
| プロジェクトでの役割 |  |

**３．応募の目的**

|  |  |
| --- | --- |
| 応募の目的を、米国との関連を含めて詳述（日本語） |  |
| 応募の目的を、米国との関連を含めて詳述（英語） |  |

**４．チーム情報**

|  |  |
| --- | --- |
| 日本語チーム名(会社名) |   |
| 英語チーム名(会社名) |  |
| 概要(日本語) |  |
| 概要(英語) |  |
| 会社設立の有無 |  有　・　無 |
| 有の場合：会社概要(会社設立済みの場合のみ記入) | 本社住所　　：設立年月日　：従業員数　　：事業内容　　：資本金　　　：従業員数　　： |
| WebサイトURL(会社/研究室HP) |  |

**５．技術シーズの発明、アライアンス、研究業績（適宜図、表を使用しても構いません）**

|  |  |
| --- | --- |
| 技術シーズ内容と解決したい社会課題・顧客ニーズ(日本語) | 別途Wordに1ページ以内で記載し提出（フォントサイズ10.5ポイント、最大1,440文字程度） |
| 技術シーズ内容と解決したい社会課題・顧客ニーズ(英語) | 別途Wordに1ページ以内で記載し提出（フォントサイズ10.5ポイント） |
| 競合技術に対する優位性・革新性(日本語) |  |
| 競合技術に対する優位性・革新性(英語) |  |
| 技術シーズに関する知的財産の状況 |  |
| 技術シーズに関連する研究業績 |  |
| 想定している商品・サービス(具体的アプリケーション)(日本語) |  |
| 想定している商品・サービス(具体的アプリケーション)(英語) |  |